
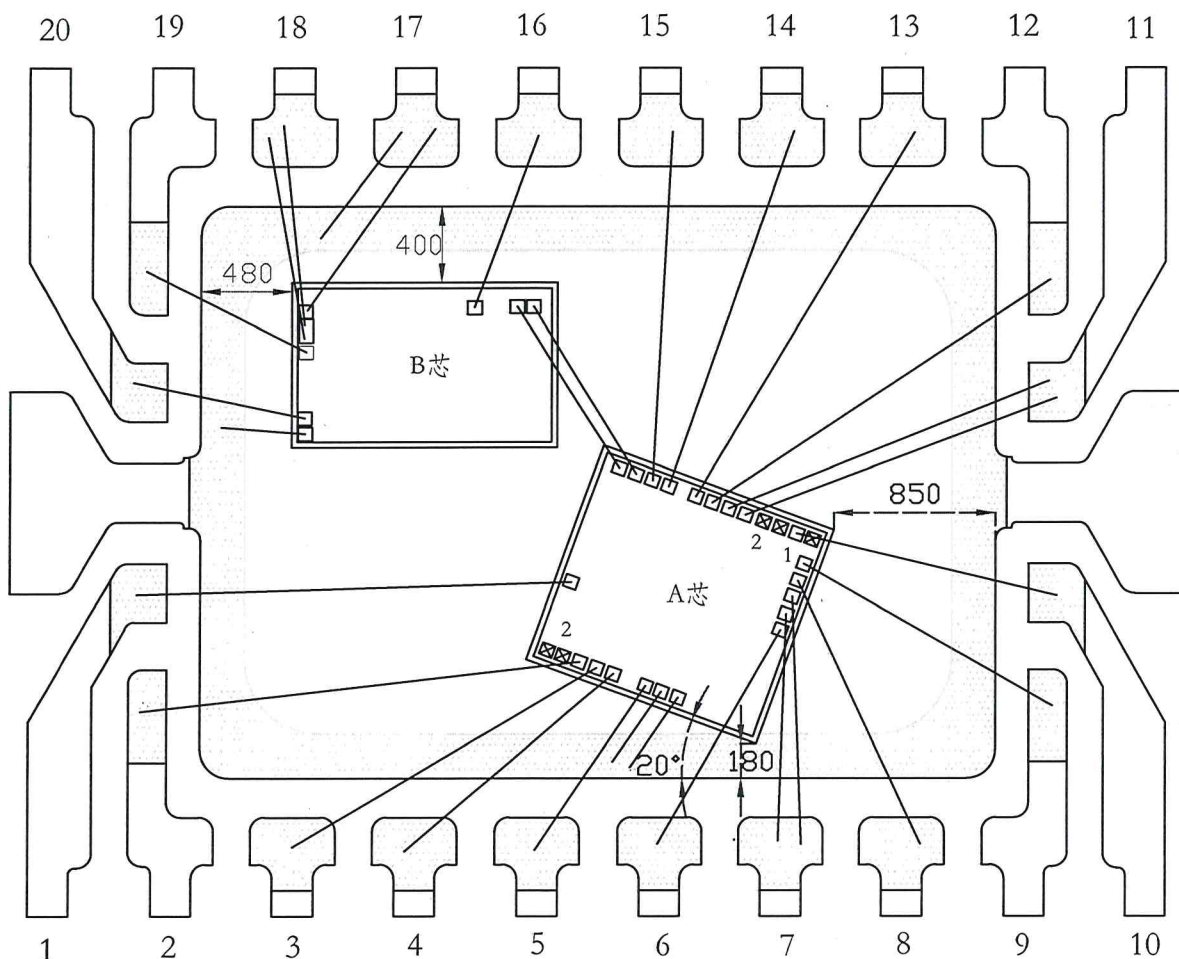
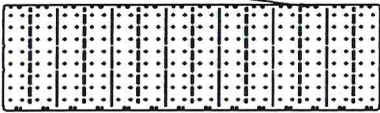


<div></div> <div>池州华宇电子科技股份有限公司 CHI ZHOU HISEMI ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD</div>				客户代码 Customer No.		008	线图号 Drawing No.		HY-PX-008-733 A			
焊线图纸 Bonding Diagram				产品名称 Product Type		HS24G003N		封装外型 PKG Type		TSSOP20		
焊线种类 Wire Type	焊线直径(um) Wire Diameter	焊线根数 NO. of wire	焊线总长(um) Total wire length	最长线长(um) Longest wire length	最短线长(um) Shortest wire length	塑封料型号(绿色环保) Compound Type (Green)			LF载体尺寸 LF Pad Size			
合金丝 Ag	20	29	45794	2329	442	首选(Preferred): EME-G630AY 备选(Optional): CEI-1702HF			TSSOP20L-8R (118X165mil) <sup>2</sup> (3000X4200um <sup>2</sup> )			

客户图号 Customer drawing NO.	
------------------------------	--



框架传送方向(装片): L/F Direction (D/A):		实物图: Chip photo:		特殊说明 Special Instructions:	
				DB注意: 1、以随工单要求按顺序装片,如:先装A芯片,装B芯片时必须装在有A芯片的框架,反之先装B芯片,装A芯片时B芯已经装片; 2、控制溢胶,为WB预留焊线位置; WB注意: 1、数字为PAD不打线个数; 2、植球点在B芯;	

说明 Instructions	粘片胶类型 Epoxy type	芯片名称 Die name	芯片尺寸 Die Size	最小焊盘尺寸 Min BPO (um <sup>2</sup> )	最小焊盘间距 Min BPP(um)	铝垫厚度(um) Pad Thickness	焊盘下是否有电路 Circuit under Pad	划片道宽度 Street line (um)	晶圆尺寸 Wafer Size	是否Low-K Low-K ?	减薄厚度 (um) Wafer Thickness
A芯: DIE A	导电胶 (conductivity) S502	HS5129	1239*1138(um <sup>2</sup> ) 48.78*44.80(mil <sup>2</sup> )	70*65	60	0.8	是/Yes	60	8	否/NO	200
B芯: DIE B	导电胶 (conductivity) S502	NIU003A	1342*804(um <sup>2</sup> ) 52.83*31.65(mil <sup>2</sup> )	60*60	60	2.0	是/Yes	60	8	否/NO	200
C芯: DIE C											

制图日期 Create Date		2024/2/5		生效日期 Effective Date				客户确认签字/盖章: Customer Signature	
拟制 Prepared by	周敏		审核 Checked by	张强 2024.2.6		批准 Approved by			